

锌和氮离子注入 $\text{GaAs}_{1-x}\text{P}_x$ 的光学和电学特性

李国辉 张通和 来永春 卢武星

(北京师范大学低能核物理研究所)

王 红 英

(苏州半导体厂)

1980年5月19日收到

本文主要研究了锌、氮离子注入 $\text{GaAs}_{1-x}\text{P}_x$ 提高发光效率的机理。从锌在 $\text{GaAs}_{1-x}\text{P}_x$ 中的剖面看出,在 p-n 结附近锌的浓度比较低,结果降低了发光层中沉积的锌原子对光的吸收。在 77K 的温度下,从阴极荧光光谱可以看出氮在 $\text{GaAs}_{1-x}\text{P}_x$ 中已经形成了等电子陷阱。用锌、氮离子注入制作的发光二极管发光效率提高了近一倍。

一、实 验

在 $\text{GaAs}\langle 100 \rangle$ 单晶片上外延生长 n 型 $\text{GaAs}_{1-x}\text{P}_x$ ($x \approx 0.4$)。外延层浓度是 $1 \times 10^{17} \text{cm}^{-3}$, 厚度是 $80 \mu\text{m}$, 氮注入的能量是 160keV, 剂量是 $1-5 \times 10^{14} \text{cm}^{-2}$, 锌注入的能量是 80 keV, 剂量是 $2-4 \times 10^{15} \text{cm}^{-2}$, 注入时靶温是 350°C 。注入后的样品在 6000 \AA 厚的 SiO_2 层保护下真空封管退火, 最后, 用离子注入工艺制备了发光二极管。

二、提高发光效率的原因

离子注入提高发光效率的原因有以下几点:

1. 锌离子注入所形成的 p 区有宽的发光区域

锌、氮离子注入后的 $\text{GaAs}_{1-x}\text{P}_x$ 样品在 850°C 下经 35 分钟退火。我们用解理染色法

测量了结深。从照片(图 1)中看出在 p 区中间有一明显界限, 这就是 p^+ 和 p^- 区的分界线, 此结果与 Yasuhiro^[1] 等人所得的基本一致。这说明在 p-n 结附近锌的浓度比较低形成了指数尾巴。这样大大减少了 p 区内的光吸收。Yasuhiro^[1] 的光致发光测量也说明了锌离子注入形成的 p 区有很宽的发光区域。



图 1 锌、氮离子注入 $\text{GaAs}_{1-x}\text{P}_x$ 850°C 退火 35 分钟 p-n 结染色象

2. 氮离子注入形成等电子陷阱^[2,3]

在 77K 下, 用电子探针测量的锌、氮离子注入 $\text{GaAs}_{1-x}\text{P}_x$ 样品的阴极荧光光谱, 示于图 2。由图可见退火温度在 750°C 以上时光谱中出现了两个发光峰^[1]。这两个峰的高度随退火温度的提高而增加。通过分析和计算证明这两个峰分别是 N_x 和 Γ 峰。 N_x 峰是单个氮中心, 它是与 x 导带底能级相关联的束缚激子复合形成的, 而 Γ 峰是与锌受主有关的复合起主导作用的带边峰。这样氮在 $\text{GaAs}_{1-x}\text{P}_x$ 中起到了等电子陷阱的作用, 形成了发光中心。这就是注入氮之所以能提高发光效率的原因。

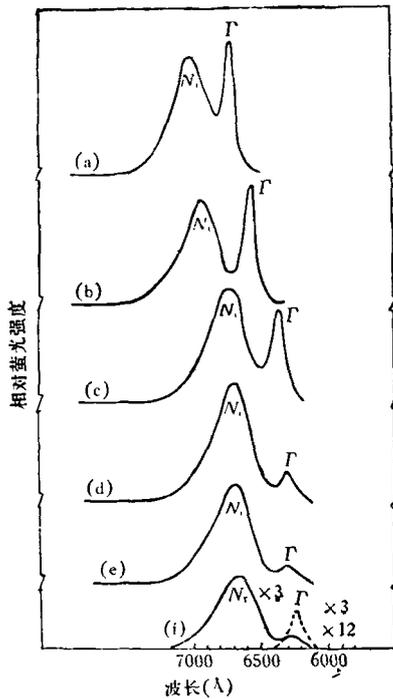


图2 锌、氮注入 $\text{GaAs}_{1-x}\text{P}_x$ 在 77K 下的阴极荧光光谱

Zn^+ : 80keV, $4 \times 10^{13}\text{cm}^{-2}$; N^+ : 160keV, $1 \times 10^{14}\text{cm}^{-2}$; a 为 1000°C 退火 6 分钟, b 为 950°C 退火 10 分钟, c 为 900°C 退火 20 分钟, d 为 850°C 退火 35 分钟, e 为 800°C 退火 2 小时, f 为 750°C 退火 4 小时, 虚线表示未退火

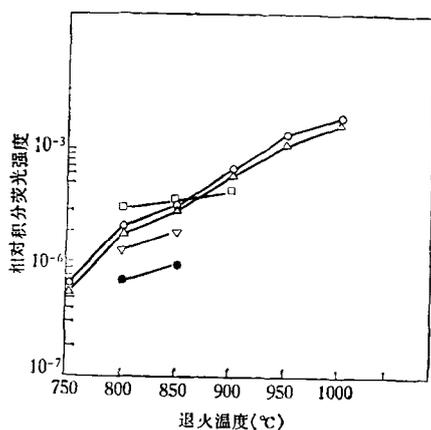


图3 锌、氮注入 $\text{GaAs}_{1-x}\text{P}_x$ 在室温下积分荧光强度和退火温度的关系

Zn^+ : 80keV, $4 \times 10^{13}\text{cm}^{-2}$; N^+ : 160keV, \square 为未注氮, \circ 为 $1 \times 10^{14}\text{cm}^{-2}$, \triangle 为 $5 \times 10^{14}\text{cm}^{-2}$, ∇ 为 $1 \times 10^{15}\text{cm}^{-2}$, \bullet 为 $5 \times 10^{15}\text{cm}^{-2}$

3. 用离子注入可选择最佳的掺杂浓度

我们对锌注入后的 $\text{GaAs}_{1-x}\text{P}_x$ 样品又分别用 $1 \times 10^{14} - 5 \times 10^{15}\text{cm}^{-2}$ 四个剂量注入氮, 样品经退火后在室温下测量了积分荧光强度 (图3). 从中看出氮的剂量在 $1 - 5 \times 10^{14}\text{cm}^{-2}$ 时有比较高的积分荧光强度. 而氮剂量比较大时荧光强度反而比较低. 因此要提高发光效率必须控制好掺杂氮的浓度, 离子注入的特点正是能很好地控制掺杂浓度, 因此用离子注入提高发光管的发光效率是适宜的.

三、离子注入退火条件的选择

为了获得高发光强度的发光二极管, 我们考虑到要使发光材料中光吸收小, 使少数载流子能充分进行辐射复合. 因此选择的 p-n 结深在 $2\mu\text{m}$ 左右.

当锌注入 $\text{GaAs}_{1-x}\text{P}_x$ 的能量采用 400 keV 时, 平均投影射程为 $R_p = 1600 \text{ \AA}$. 要使锌原子从这样的注入深度达到 $2\mu\text{m}$ 的结深, 必须对注入的锌进行再扩散.

1. 锌在 $\text{GaAs}_{1-x}\text{P}_x$ 中的再扩散

我们认为离子注入层中的再扩散也同样遵循由 Fick 定律推出的热扩散方程^[4]. 从这个方程的简化解可以得到结深 X_j 和扩散系数 D 的近似关系为 $X_j \approx A \sqrt{Dt}$, 其中 t 为扩散时间, A 在峰值浓度和衬底浓度一定时为一常数. 图 4 中表示了 750—1000°C 退火时所得的 $A \sqrt{D} - \frac{1}{T}$ 的关系.

我们从载流子纵剖面分布 (850°C 退火, 几种不同的退火时间) 中得到了 850°C 时锌在 $\text{GaAs}_{1-x}\text{P}_x$ 中的扩散系数 D , 其值是 $1.3 \times 10^{-12}\text{cm}^2/\text{sec}$. 从而我们就能找到不同退火温度的扩散系数, 并且确定制作发光管的退火条件.

2. $\text{GaAs}_{1-x}\text{P}_x$ 注入层的电特性和损伤恢复

我们用范德堡尔法测量了锌、氮注入后的

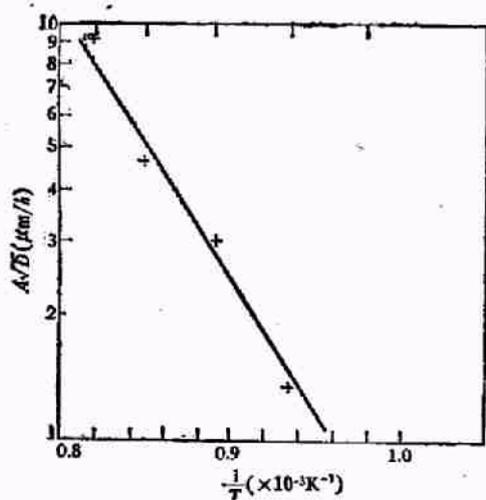


图4 锌在 $GaAs_{1-x}P_x$ 中扩散的 $A\sqrt{D}$ 与 $1/T$ 的关系 (T 为退火温度的绝对温度)
 Zn^+ : 80keV, $4 \times 10^{15} cm^{-2}$; N^+ : 160keV, $5 \times 10^{14} cm^{-2}$

薄层载流子浓度 N_s 、电阻率 ρ_s 和迁移率 μ_H 与退火温度 T_s 的关系(图5)。从图中看到 900°C 退火激活率达到 100%。电子衍射测量表明, 850°C 退火的样品出现了布拉格(Bragg)点。图

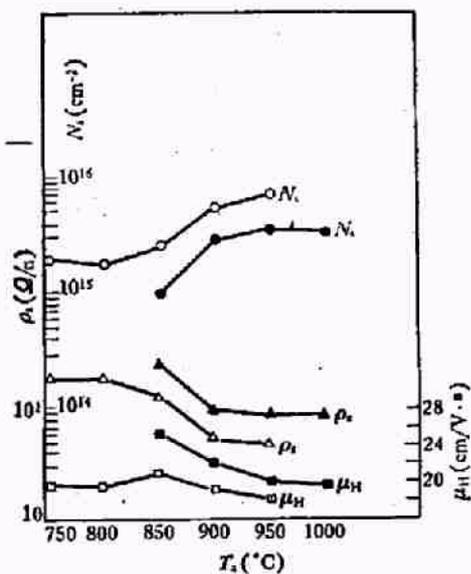


图5 锌、氮离子注入 $GaAs_{1-x}P_x$, N_s , ρ_s , μ_H 与退火温度的关系

Zn^+ : 80keV, $4 \times 10^{15} cm^{-2}$ 时的 N_s , ρ_s , μ_H 用空心符号表示; $2 \times 10^{15} cm^{-2}$ 时的 N_s , ρ_s , μ_H 用实心符号表示

6 进一步说明离子注入辐射损伤基本消除, 而在 950°C 以上退火的样品表面产生了热分解。

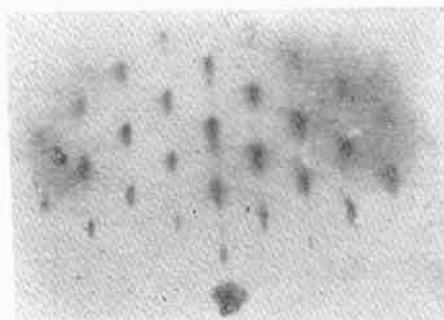


图6 锌、氮注入 $GaAs_{1-x}P_x$ 850°C 退火后电子衍射图

从以上分析, 我们认为锌、氮离子注入 $GaAs_{1-x}P_x$ 的退火温度选择在 850—900°C 为最佳。

四、制管的初步结果

用上述最佳的注入和退火条件制备了台面发光二极管。在同一个样品上采用离子注入和热扩散两种方式制管。结果表明用离子注入制备的发光管比热扩散的发光效率高 84—93%, 而注入锌和氮的样品比只注锌的发光效率高 20—30%。

本工作得到中国科学院半导体所、北京有色所、1411 所的大力协助, 在此表示感谢。

参加本工作的还有马玉岗、苏颖、吕贤淑、沈京华等。

参 考 文 献

- [1] Yusuhiro Shiraki et al., Applications of Ion Beams to Materials, Conference Series Number 28, The Institute of Physics London and Bristol, (1975), 86.
- [2] R. E. Anderson et al., J. Appl. Phys., 48-6(1977), 2453.
- [3] 李国辉、庄蔚华、李成基、周德明, 北京师范大学学报(自然科学版), 1(1980), 47.
- [4] P. D. Townsend et al., Ion Implantation Sputtering and Their Applications, Academic Press London, New York, San Francisco, chapter 5, (1975), 88.